

N-putty

ノンシリコン熱伝導パテ

LiPOLY N-putty はノンシリコン熱伝導材料で、低分子シロキサンが揮発せず、全揮発ガスが少ないです。熱伝導率が 3.5 W/m*K の高い変形により、小さな空隙を完全に埋めて公差をなくし、オーバーフローやドライアウトの問題を克服して熱伝導率を高めることができます。N パテはサーマルペーストの優れた代替品であり、自動ディスペンサー装置でのディスペンスに最適です。

■ 製品の特性

- / 熱伝導率: 3.5 W/m*K
- / 推奨塗布厚み 100~1500μm
- / ノンシリコン樹脂素材
- / 公差を補われる特性
- / 精密部品には圧力をかけず
- / 垂れせず
- / バッチ生産可能
- / 高圧縮及び低応力環境には適合

■ 製品アプリケーション

- / CPUと放熱シンクの間
- / PCコンポーネントと放熱シンクの間
- / 高速記憶装置
- / 通信設備
- / フラットパネルディスプレイ
- / セットトップボックス
- / ネットワークカメラ
- / 5Gの基地局(基幹施設/設備)
- / 電気自動車

■ 容量の単位

- / カートリッジ: 30ml, 55ml, 330ml
- / ペール缶: 1kg, 25kg

■ 保存期間

- / 当製品が未使用の状態、室温30度の条件には60ヶ月が保存できます。

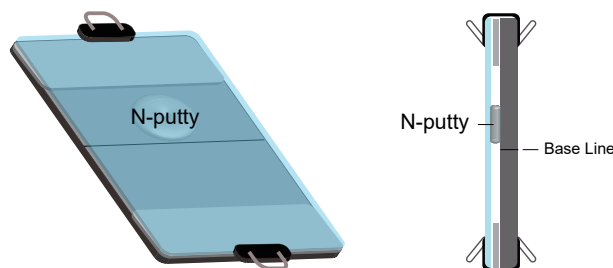


■ 代表特性

物理特性	N-putty	試験方法	単位
色	Gray	Visual	-
主成分	Non-Silicone	-	-
粘度	15000	DIN 53018	Pa.s
流量 (30cc EFDチューブ、内径2.35mm、90psi&60s)	14	By LiPOLY	g/min
密度	3.0	ASTM D792	g/cm ³
使用温度	-60~150	-	°C
推奨塗布厚み	100~1500	-	μm
質量損失比	<0.20	By LiPOLY	%
保存期間	60 months	-	-
ROHS & REACH	Compliant	-	-
電気特性			
絶縁破壊電圧	12	ASTM D149	KV/mm
体積抵抗率	>10 ¹³	ASTM D257	Ohm-m
熱特性			
熱伝導率	3.5	ASTM D5470	W/m*K
熱抵抗@10psi / 80°C	0.066	ASTM D5470	°C-in ² / W
熱抵抗@30psi / 80°C	0.059	ASTM D5470	°C-in ² / W
熱抵抗@50psi / 80°C	0.051	ASTM D5470	°C-in ² / W

■ 垂れ落ち試験

1.5mmのシートを使って、隙間調整を行う。パティをアルミ板とガラス板の間に乗せて、試験前にはパティの位置を表記し、125°Cのオーブンに1000時間ベーキングした後を取り出して、パティの位置を再確認する。



高温試験終了後、材料は元の位置からずれるかを確認する